

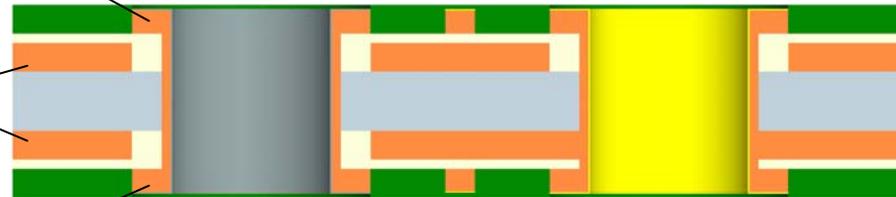
Fertigung Multilayer

Aufbau des Multilayers (4-Lagen)

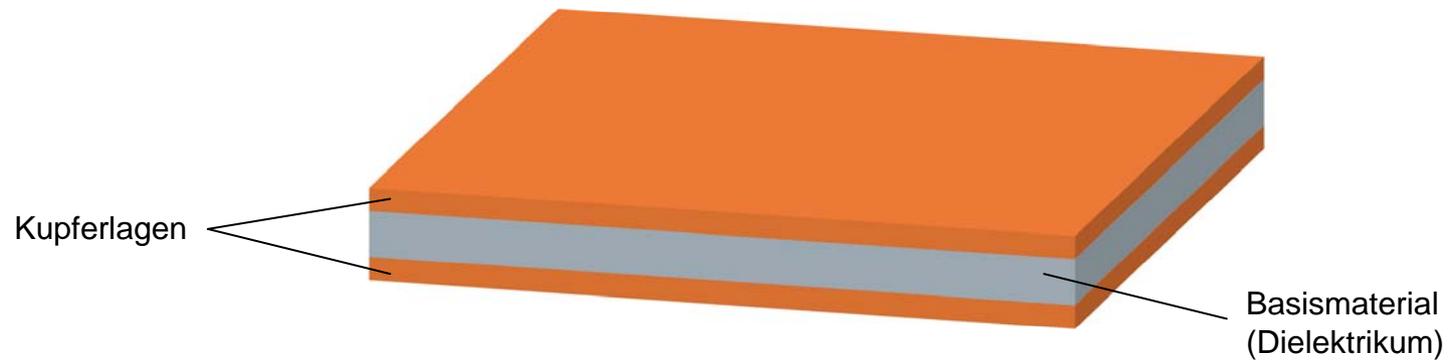
Kupfer-Außenlage

Kupfer-Innenlagen

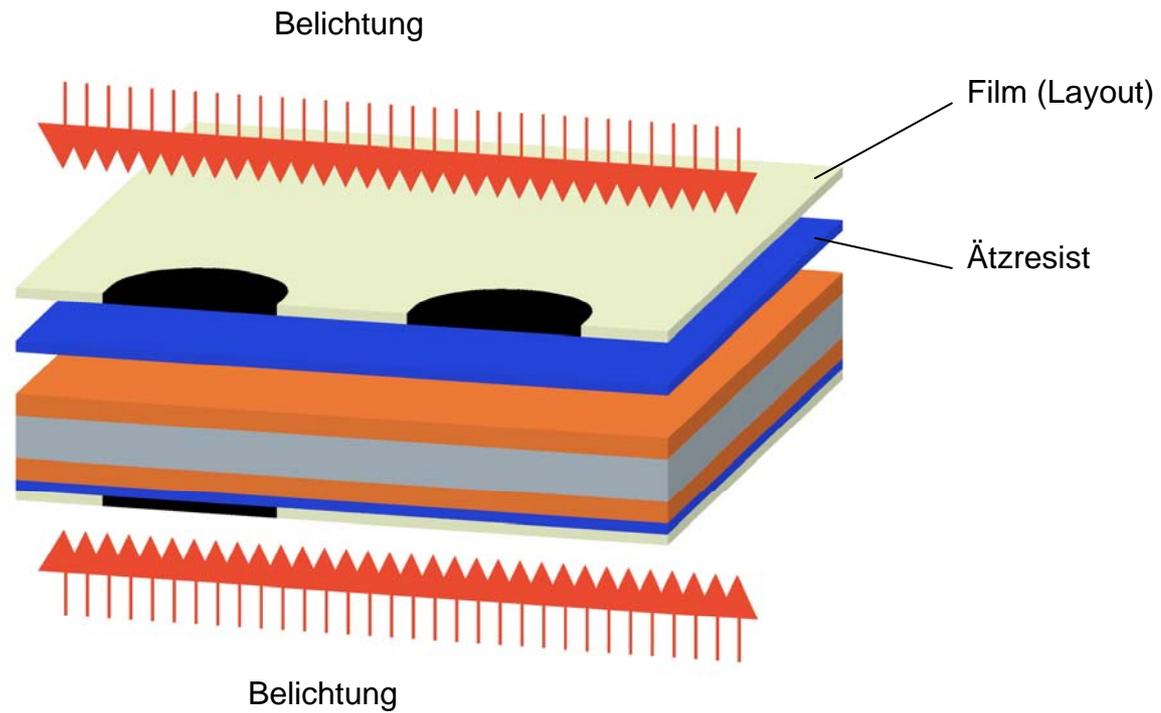
Kupfer-Außenlage



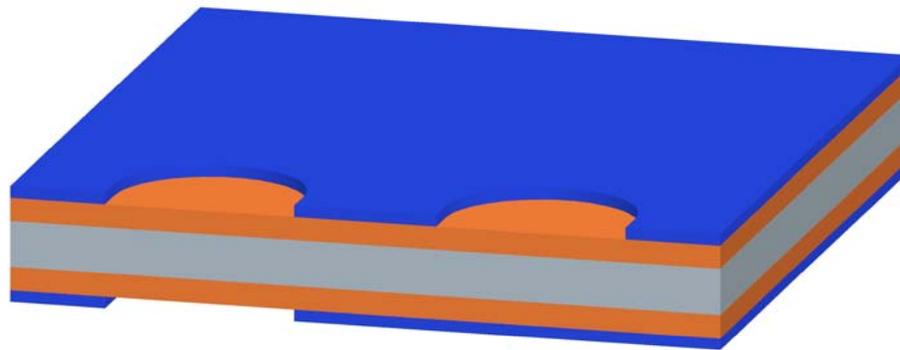
1. Zugeschnittene Innenlagen (Kern)



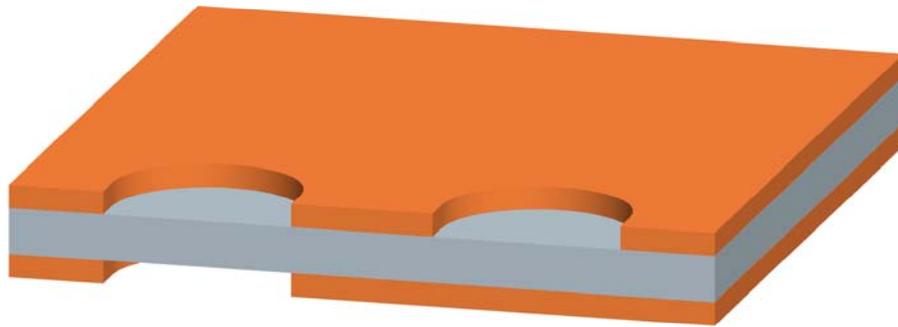
2. Layoutstrukturierung der Innenlagen



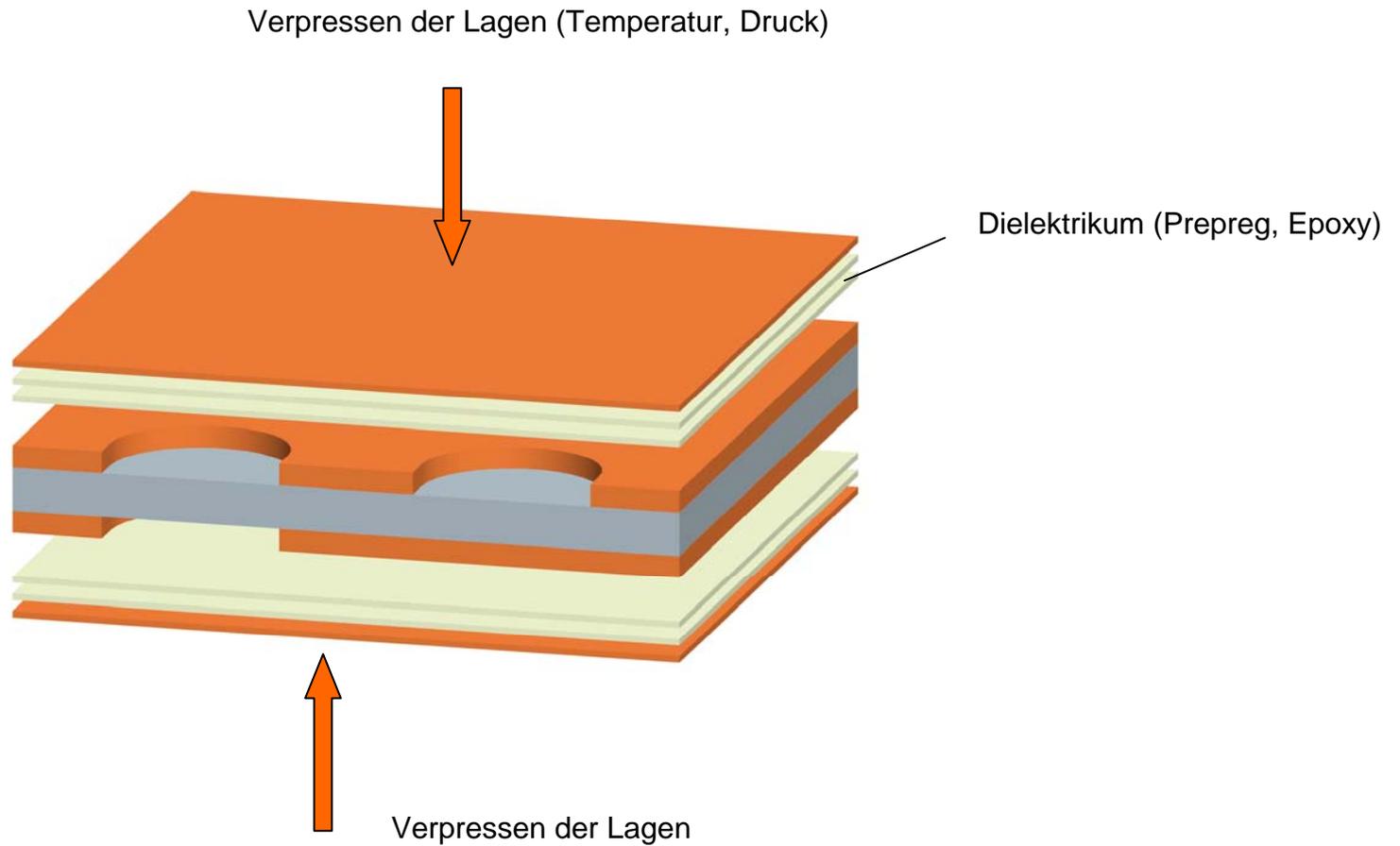
3. Strukturierter Ätzrestist für Innenlagen



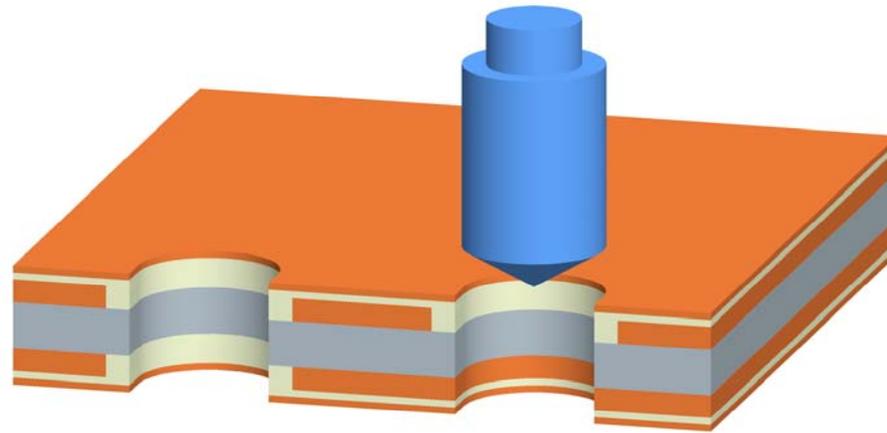
4. Geätzte Innenlagen (mit entferntem Ätzresist)



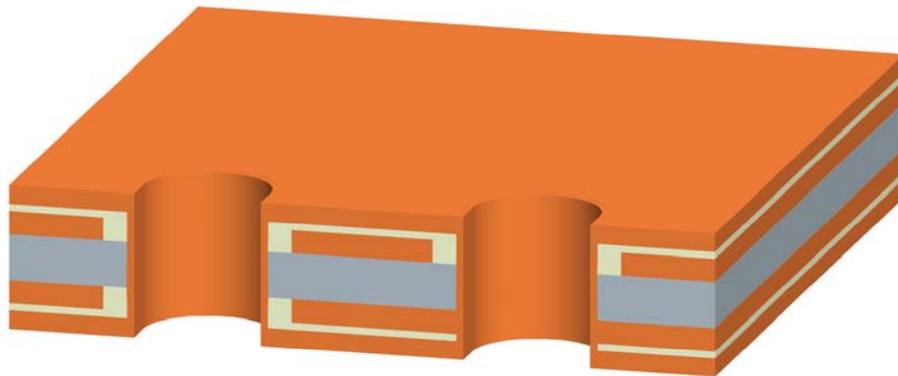
5. Gestapelte Innen- und Außenlagen (Lay-up)



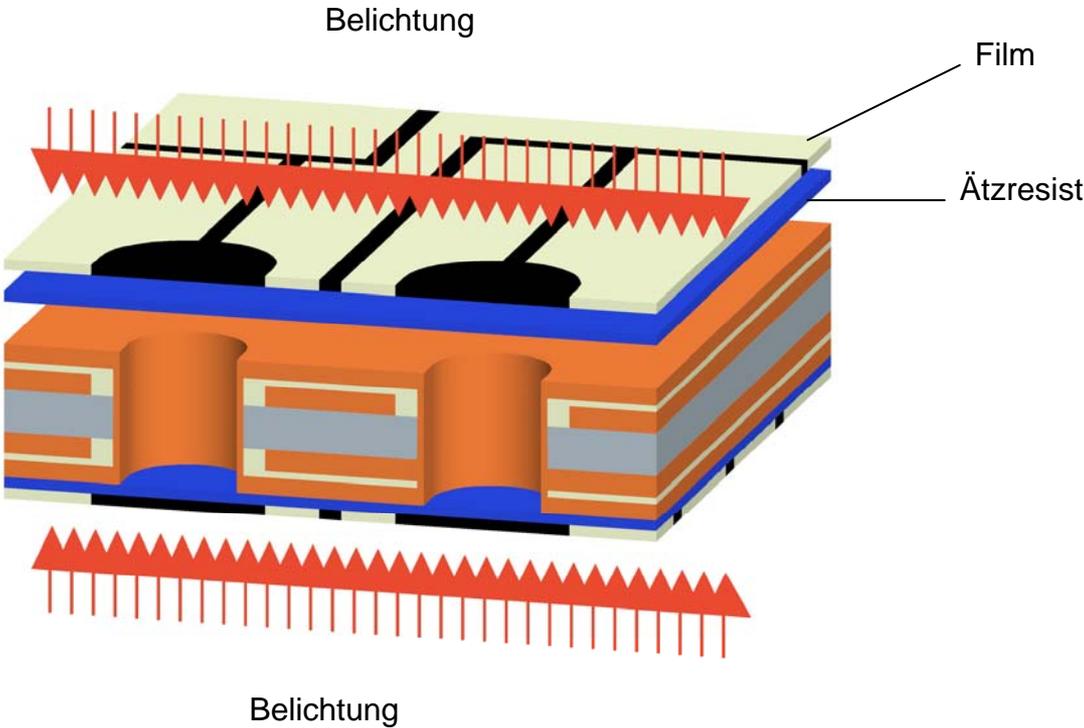
6. Gebohrter Multilayer



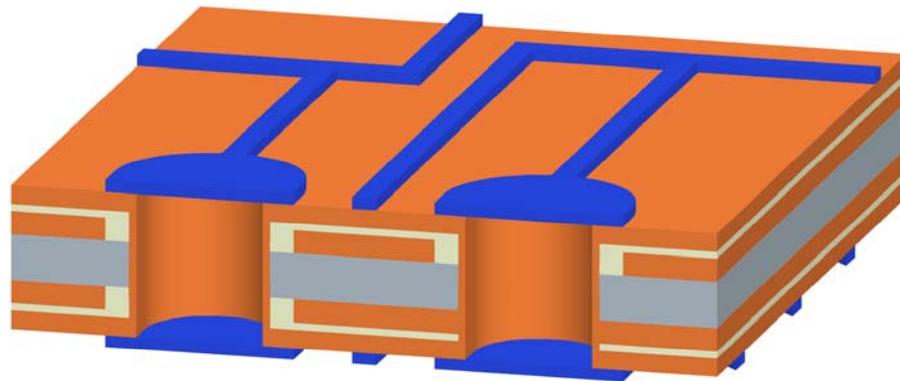
7. Metallisierter Multilayer (Kupfer)



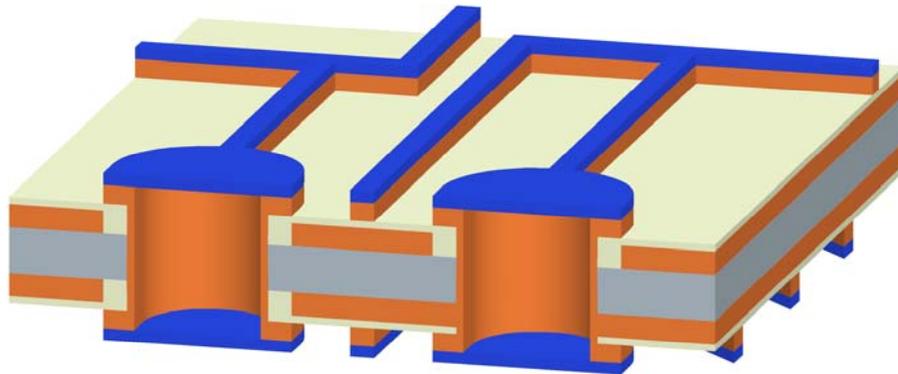
8. Layoutstrukturierung der Außenlagen



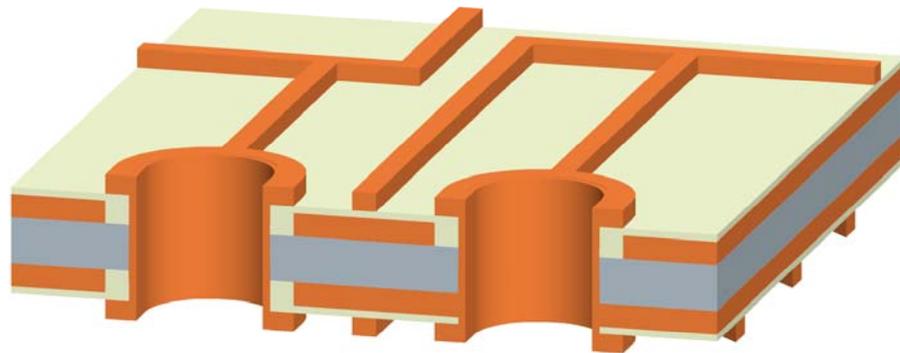
9. Strukturierter Ätzresist für Außenlagen



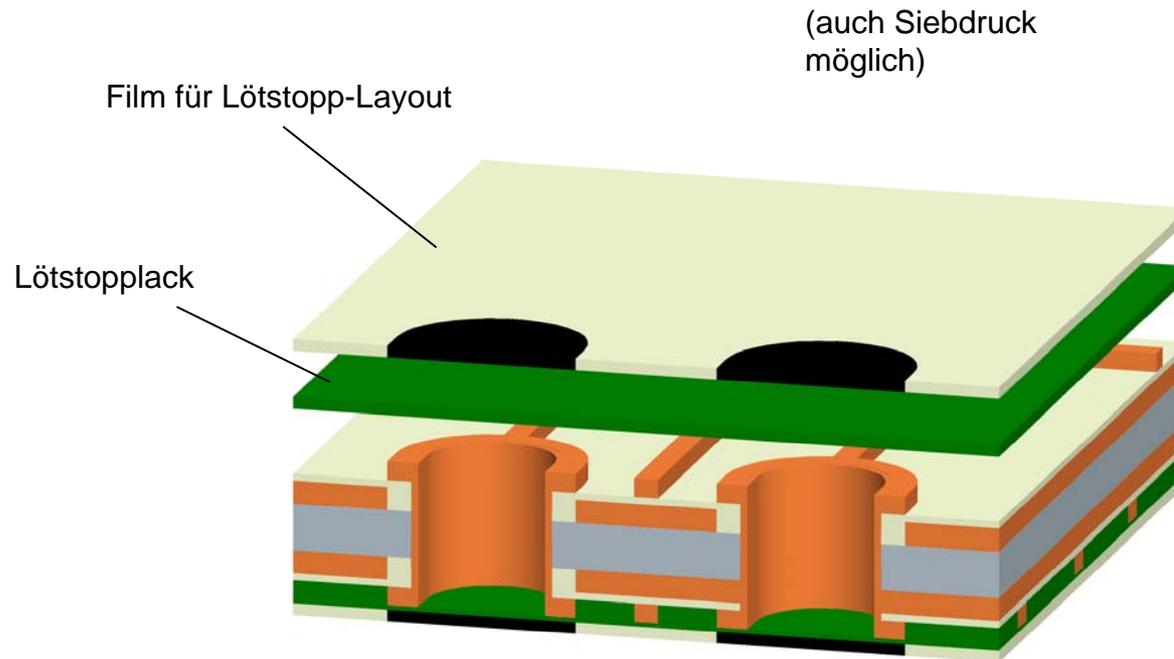
10. Geätzte Außenlagen



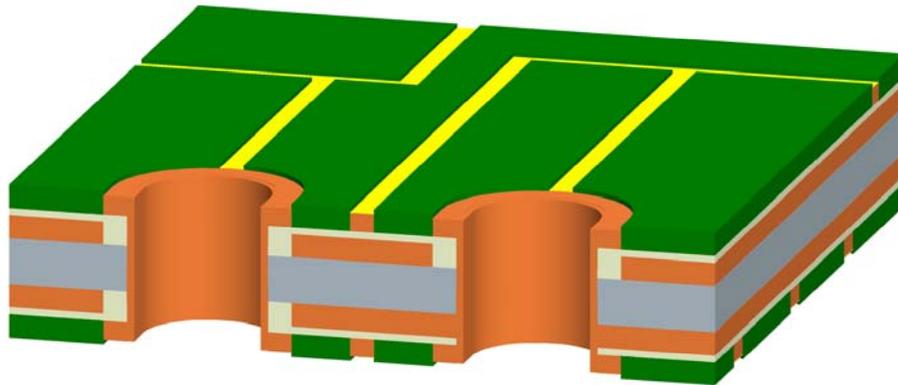
11. Multilayer mit entferntem Ätzresist



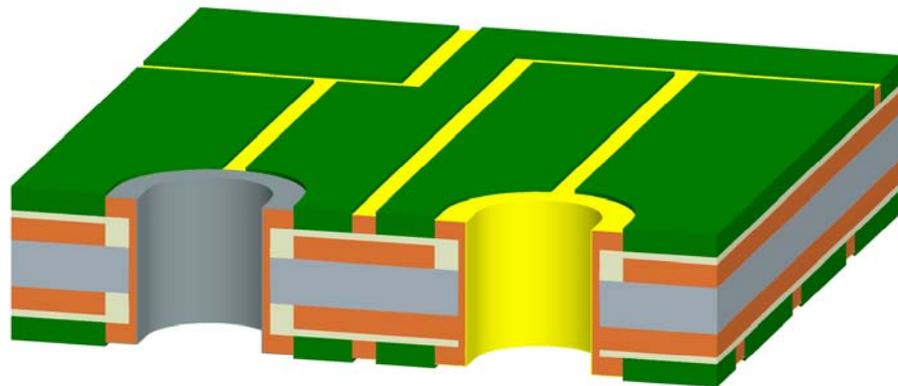
12. Layoutstrukturierung des Lötstopplacks



13. Strukturierte Lötstopp-Maske



14. Oberflächenvergütete Kontaktflächen



Zinn (Sn)
Zinn/Blei (Sn/Pb)

Nickel/Gold (Ni/Au)

15. Elektrisch getesteter Multilayer

